

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部**部品構成表**

製品名(鉛フリー): XCM524xxxxDR-G

標準質量: 9 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	1.272	シリコン	141400	7440-21-3
		- 砒素	8	7440-38-2
リードパッド	2.248	ニッケル	249800	7440-02-0
		銀	19800	7440-22-4
		金	3600	7440-57-5
ダイアタッチ	0.025	エポキシ樹脂	2800	—
		溶融シリカ	2500	60676-86-0
ボンディングワイヤ	0.255	金	28300	7440-57-5
封止樹脂	4.470	溶融シリカ	496700	60676-86-0
		エポキシ樹脂	30400	—
		フェノール樹脂	24800	—

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。